

地域未来投資促進法に基づく承認地域経済牽引事業計画

資料

【事業計画】

CMP装置をはじめとする半導体製造装置の開発能力拡大に向けた開発棟の建設

【事業者】

企業名：株式会社荏原製作所 藤沢事業所
所在地：藤沢市本藤沢4丁目2番1号
営業品目：半導体製造装置の開発、製造、販売

【事業概要】

- 背景
 - ・同社は半導体製造装置におけるCMP技術（半導体ウェーハの表面を平坦化する技術）の分野で約30%の世界シェアを持っている。
 - ・一方で、IoT技術や5Gの普及等による半導体関連需要が拡大しており、多様化する顧客ニーズに応えるために開発力の向上が求められている。
- 事業内容
 - ・藤沢事業所において設備と人材の拡充を行うとともに、同事業所内に新開発棟を建設することで、開発能力を増強する。
 - ・半導体製造装置市場における競争力を高めることで、需要を確実に取り込み、シェア拡大を図る。
 - ・これにより、付加価値創出額33億4,700万円を目指す。

新開発棟（完成予想図）



新施設の概要

- 階数：地上4階、地下1階建
- 立地場所：藤沢市本藤沢4丁目2番1号
- 延床面積：16,243㎡
- 着工：2023年5月 竣工：2025年6月

顧客ニーズへの対応強化

- ・新開発棟に自社の半導体製造装置を設置し、より高度な平坦化技術など、半導体製造プロセスの開発能力を増強することにより、顧客の多様なニーズに対応
- ・新開発棟にクリーンルームを見学できるデッキを設置し、実際にCMP装置が稼働している様子を見られるようにすることにより、顧客対応力の向上及び新規顧客の獲得